

平成27年7月13日

公募の通知

部品内蔵基板製造工程における検査装置への最終版インターフェース開発公募要領

[1] 公募期間（期間厳守）

平成27年7月14日～平成27年7月27日（※最終日は17時まで）

[2] 開発内容

昨年度実施した基板製造工程における検査装置へのインターフェース改良開発の更なる改良を行い、最終版インターフェースを開発する。

(1) 開発の概要

昨年、FUJIKO から検査装置情報に変換する実用レベルの製品リリース可能な機能を開発した。本年度はその最終版を開発する。

(2) 具体的内容

昨年開発した FUJIKO から電気検査機への情報ソフト WEDIT（日置電機検査機の検査情報）への変換プログラムについて、以下の2点を追加した、最終版 FUJIKO に対応させた変換プログラムを開発する。

- ① 製品用情報として、表面および基板内に実装・内蔵する部品の情報を取り込む FUJIKO のデータを読み込み、変換すること。
- ② 検査用データを、気検査機への情報ソフト WEDIT の情報として変換すること。

[3] 公募提出物等

(1) 提出物：① 会社概要、② 見積書、③ 開発内容に対する企画書

① ②は紙での提出。③は CD-R 又は DVD-R でのデータ提出。

様式はいずれも任意。ただし企画書には、FUJIKO データを検査装置の作業データに変換出力するにあたっての機能仕様書イメージに関する記述を含めること。

(2) 提出先：福岡大学 半導体実装研究所

[4] 審査

審査委員会において審査の上、決定。

[5] 審査結果決定、発注先通知

平成27年7月31日

[6] 開発期間

平成27年8月1日～平成27年11月30日

[7] 納入締切・納入先

平成27年12月1日

納入先：福岡大学半導体実装研究所

納品物：開発した最終版インターフェース機能仕様書

[8] 検証（予定）

平成27年12月2日～平成27年12月15日

[9] 検収（予定）

平成27年12月16日

[10] 本件に関する問合せ先、見積等資料提出先、提出方法

郵送による提出のみ

福岡大学半導体実装研究所 加藤義尚宛

〒819-1122 福岡県糸島市東1963-4

三次元半導体研究センター内

TEL:092-332-9144 E-Mail:ykatoh@fukuoka-u.ac.jp

以上